

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

# 디에이피(066900)

## IT부품

요약  
기업현황  
재무분석  
주요 변동사항 및 전망



작성기관

NICE평가정보(주)

작성자

황보현 전문연구원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술 신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미 게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2124-6822)으로 연락주시기 바랍니다.

# 디에이피(066900)

국내 Build-up PCB 시장을 선도하는 HDI PCB 제조 전문기업

## 기업정보(2021/09/31 기준)

대표자	권오일/최봉운
설립 일자	1987년 11월 28일
상장 일자	2004년 05월 14일
기업 규모	중견기업
업종분류	인쇄회로기판용 적층판 제조업
주요제품	인쇄회로기판

## 시세정보(2022/02/07 기준)

현재가(원)	4,150
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	944
발행 주식 수	22,744,503
52주 최고가(원)	5,200
52주 최저가(원)	3,135
외국인지분율	0.72%
주요주주	(주)대명화학

### ■ 다층 인쇄회로기판(이하 PCB, Printed Circuit Board) 제조 선도기업

디에이피(이하 동사)는 Build-up PCB 전문 제조업체로 30년 이상 사업을 영위해 오면서 높은 생산수율과 효율적인 공정운영, 신속한 물류시스템을 구축하였다. 이를 기반으로 고난이도의 기술력을 요하는 스마트폰용 고밀도 주기판(이하 HDI, High Density Interconnection) PCB와 자동차 전장용 PCB 등을 생산하여 현대모비스, 삼성전자 등 국내 대기업 자동차 부품 및 전자제품 제조사에 공급하고 있다. 중국, 베트남, 인도, 브라질, 독일 등 글로벌 시장에도 진출하였으며, 기업 비전인 ‘기술혁신’, ‘수율혁신’, ‘원가혁신’을 실현하기 위해 꾸준한 연구개발과 시설투자를 진행 중으로, 향후에도 국내 HDI PCB 시장을 선도할 수 있을 것으로 전망된다.

### ■ 고부가가치의 Build-up PCB 제조를 위해 연구개발 집중

동사의 주력 분야인 다층 및 Build-up PCB는 전체 PCB 산업에서 40% 이상을 차지하며, 복잡한 제조 공정과 고도화된 기술력이 요구되는 분야이다. 2001년부터 기업부설연구소를 운영하여 D/F 회로 구현, Laser/CNC Drill 최적 가공, PSR 및 표면처리, 비아홀 Plating 기술 등 Build-up PCB 제조와 관련한 공정 기술과 PCB 비아 Fill 약품, 현상단세정제, PLUG 잉크 등 원부자재의 국산화를 위한 연구개발에 매진하고 있으며, 각 공정에 최적화된 기술을 통해 고품질 제품을 생산하고 있다.

### ■ 차량용 레이더 PCB 개발로 자동차 전장용 PCB 제조시장 신규 진입

자동차 전장용 PCB는 고집적화, 소량화의 기술에 기여할 뿐만 아니라 사용자의 안전과 직결되는 제품특성 상 진입장벽이 높아 해외 기업이 선도하고 있는 분야이다. 자동차의 전장화로 더 많은 전자부품이 탑재될 것으로 예상되며, 관련 시장 또한 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 전망된다. 이에 동사는 전문분야인 이동통신단말용 PCB 제조에만 한정하지 않고 2여 년의 연구개발 끝에 차량용 레이더 기판을 개발함으로써 제품 수요처를 다각화하고 있다.

## 요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	3,041	2.1	116	3.8	75	2.5	7.6	3.3	113.3	330	5,579	8.0	0.5
2019	2,705	(11.1)	8	0.3	10	0.4	1.0	0.4	124.4	44	5,558	81.7	0.6
2020	3,013	11.4	82	2.7	50	1.7	4.9	2.2	113.4	220	5,950	18.4	0.7

## 기업경쟁력

### 핵심경쟁력

- 다년간의 Build-up PCB 개발 및 제조 경험 보유
  - 경박단소화(輕薄短小化)를 위한 Build-up 가공 기술을 지속적으로 연구 및 발전시켜 슬림화되고 있는 PCB의 품질 향상구현
- 기술경쟁력을 바탕으로 스마트폰 HDI PCB 시장 선도
  - 30년 이상의 PCB 개발 및 제조 경험을 바탕으로 고난이도의 스마트폰 HDI PCB 제조에 특화된 기술 노하우 확보하여 국내 HDI PCB 시장을 선도

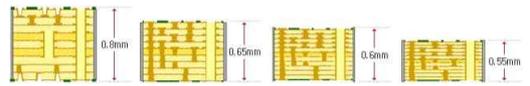
### 경쟁력 강화 전략

- 품질 혁신 및 공정 효율화를 위한 프로세스 구축
  - 불량 시 개선 및 검증 확인 후 재가동하는 Line Stop System으로 불량품 재발 방지 구현
  - 원자재 입고에서 PCB 완제품 출하에 필요한 전 프로세스를 내재화하여 Lead Time 단축
- 자동차 전장용 PCB의 상용화로 적용 분야 확대
  - 2020년 현대기아차의 차량용 레이더 PCB 공급으로 적용처 다변화 도모

## 핵심기술 및 주요 제품

### 핵심기술

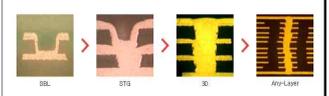
#### 경박단소화를 위한 Slim PCB 제조 기술



#### PCB 미세 회로 구현 기술



#### All Layer Laser Via Hole & Via Filling 공법



### 주요 제품

<p>MOBILE PHONE HDI PCB</p> <p>스마트폰용 PCB</p>	<p>TABLET HDI PCB</p> <p>태블릿용 PCB</p>
<p>WEARABLE HDI PCB</p> <p>웨어러블기기용 PCB</p>	<p>AUTOMOBILE HDI PCB</p> <p>자동차 전장용 PCB</p>

## ESG 현황

### Environment

항목	현황
환경 정보 공개	■
환경 경영 조직 설치	■
환경 교육 수준	■
환경 성과 평가체계 구축	■
온실가스 배출	■
에너지, 용수 사용	■
신재생 에너지	■

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

### Social

항목	현황
인권보호 정책 보유	■
여성/기간제 근로자 근무	■
협력사 지원 프로그램	■
공정거래/반부패 프로그램	■
소비자 안전 관련 인증	■
정보보호 안전 관련 인증	■
사회공헌 프로그램	■

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

### Governance

항목	현황
주주의결권 행사 지원제도	■
중장기 배당정책 보유	■
이사회 내 사외이사 보유	■
대표·이사회 독립성	■
감사위원회 운영	■
감사 업무 교육 실시	■
지배구조 정보 공개	■

■ : 양호 ■ : 미흡 □ : 확인불가

- ▶ 생산 및 영업활동과 관련된 환경 정보를 공개하고 환경 경영을 위한 조직을 두고 있음. 임직원을 대상으로 환경교육을 실시하고 있으나, 환경성과에 대한 평가체계 구축 및 신재생에너지 부문은 다소 미흡한 것으로 파악됨.
- ▶ 임직원을 위한 인권보호 정책을 보유하고 있고, 공정거래 및 반 부패 프로그램, 소비자 및 정보보호를 위한 안전 관련 인증을 보유 중임. 다만, 협력사 지원 프로그램과 사회공헌 프로그램은 운영하고 있지 않음.
- ▶ 4인으로 구성된 이사회를 운영 중이며, 사외이사를 보유하고 있어 이사회의 독립성을 유지하고 있으나 별도의 감사위원회는 운영하고 있지 않음.

\* 본 ESG현황은 나이스평가정보사가 분석대상 기업으로 입수한 정보를 요약 정리한 것으로, 분석 시점 및 기업의 참여도에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

# I. 기업현황

## 전자제품 및 자동차 전장용 Build-up PCB 전문 제조기업

디에이피(이하 동사)는 지속적인 시설투자와 꾸준한 연구개발을 통해 높은 생산수율과 효율적인 공정운영, 신속한 물류시스템을 구축하고 있으며, 이를 기반으로 고난이도 기술력을 요하는 스마트폰 및 자동차 전장용 PCB를 생산하여 공급하고 있다.

### ■ 개요

동사는 PCB 제조사업을 영위하는 기업으로 1987년 11월 데밍산업으로 설립된 후 2000년 현재의 사명인 디에이피로 변경되었으며, 2004년 05월 코스닥 시장에 상장되었다. 본사는 경기 안성시 미양면, 제품 생산을 위한 공장은 경기 안성시 미양면과 경기 안산시 단원구에 위치해 있으며, 2021년 9월 기준 1,025명의 임직원이 근무하고 있다.

동사는 다양한 전자제품의 PCB를 생산하여 현대모비스, 삼성전자, 엘지전자 등 국내 대기업 자동차 부품 및 전자제품 제조사에 공급하고 있으며, 중국, 베트남, 인도, 인도네시아, 브라질, 독일 등에도 수출하고 있다.

### ■ 사업 현황

동사의 주요 사업분야는 전자소자를 연결하는 역할을 하는 PCB 제조로, 이동통신 단말기용, 전자제품용, 자동차 전장용 PCB가 매출의 약 95% 이상을 차지하고 있고, 그 외 부산물 매출이 약 5%를 차지한다. 동사는 Build-up PCB의 생산에 주력하고 있고, 해당 제품은 스마트폰, 웨어러블기기, 디지털카메라, 자동차 부품 등에 적용되고 있다.

동사는 2006년 안성사업장 신축 후 최단 납기 실현을 위해 2010년 안산사업장을 추가로 건설하는 등 지속적인 시설투자와 꾸준한 연구개발을 통해 높은 생산수율과 효율적인 공정운영, 신속한 물류시스템을 구축하였으며, 2021년 9월 기준 연간 99.3만 m<sup>2</sup>의 PCB를 생산 가능한 것으로 파악된다.

표 1. 동사 주요 제품 및 매출현황

(단위: 백만 원, %)

구분	제품	매출액 및 비중			
		2021 3Q	2020	2019	2018
PCB	이동통신단말기용 PCB	212,623	289,142	259,400	293,929
	전자제품용 PCB	(95.13)	(95.95)	(95.50)	(96.65)
	자동차 전장용 PCB				
기타	부산물 외	10,881	12,198	11,084	10,179
		(4.87)	(4.05)	(4.10)	(3.35)
	합계	223,504	301,340	270,484	304,108
		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

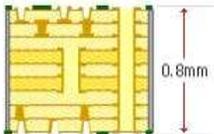
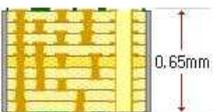
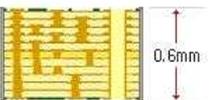
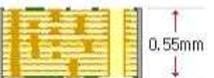
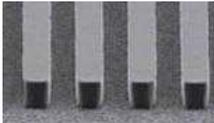
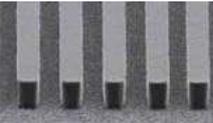
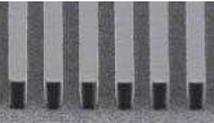
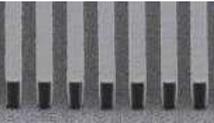
\*출처: 분기보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 주요 기술역량

동사의 주력 제품인 Build-up PCB는 도체층과 절연층을 적층하여 제작하는 다층 PCB로, 기판의 두께를 얇게 그리고 고속 신호대응이 가능하도록 설계가 가능하여 핸드폰, 스마트폰, 태블릿 PC 등 소형 전자제품에 적용되며, 작은 면적에 고밀도 실장이 가능하여 널리 사용되고 있는 기술이지만 회로 구현을 위한 높은 기술적 난이도와 복잡한 공정 등으로 진입장벽이 높다.

동사는 1987년 설립 이래 얇고 가벼우면서도 고성능의 사양을 추구하는 모바일기기에서 요구되는 경박단소화 구현을 위해 Build-up PCB 관련 기술을 개발해 왔으며, 10개의 층을 적층한 D Type, 3D 및 4D Type, 고사양 PCB 제작에 사용되는 Any Layer 등을 상용화하였다.

표 2. 동사 제품 기술로드맵

구분	2014년	2015-2016년	2017년	2018년
Structure				
Type	D, 3D Type (10L)	Any-layer (10L)	Any-layer (10,12L)	Any-layer (12L)
Line/Space	 50/50(µm)	 40/40(µm)	 30/40(µm)	 30/30(µm)

\*출처: 동사 홈페이지(2021)

동사는 HDI PCB에 특화된 공정 기술을 보유하고 있다. HDI PCB는 Build-up PCB 형태로 제작되는데, 미세 회로 기술과 레이저 비아홀(Via Hole) 기술을 적용해 만든 고밀도, 고집적 PCB를 총칭하며, 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일기기의 주기판으로 적용된다. Build-up PCB 관련 핵심 기술인 레이저 비아홀은 기존 기계 드릴로 만드는 비아홀과 달리 홀의 깊이까지 조절할 수 있으며, 작은 크기와 우수한 전기적 성능을 제공할 수 있다.

HDI PCB를 제작하기 위해서는 설계된 적층 구조에 맞춰 다층 구조로 접착, 기판에 산화피막 형성, 가열 및 가압을 통해 경화하는 공정이 필요하다. 또한, 비아홀 내부의 부유물을 제거하기 위한 Desmear 공정을 거쳐 고객 요구에 맞게 외형을 잘라내고 불량 여부를 검사한다. 이처럼 동사는 다양한 공정을 거쳐 고품질, 다기능화된 기술을 제공하기까지 각 공정별 기술 노하우를 보유하고 있는 것으로 파악된다.

표 3. 동사 보유 공정 기술

공정		설비	Process
CNC/ Laser Drill & Router	CNC Drill	층간 도통을 위한 Drill Hole 형성 공정	
	Laser Drill	절연체를 Laser로 가공하여 Via Hole 형성	
	Router	제품 외형 가공 공정	
MLB	Oxide	동 표면 산화피막 형성	
	Lay-up	적층구조와 순서에 맞게 제품과 원자재 Build-up	
	Hot Press	가열 및 가압을 통한 원자재 경화	
Plating	Desmear	가공된 Via Hole 내부의 부유물 제거	
	화학동도금	화학반응을 통한 얇은 1차 도금층 형성	
	전기동도금	기판에 전류를 가하여 구리도금 실시	
D/F	Exposure	Dry Film Laminating된 제품을 Laser 광원을 이용하여 경화	
	Etching	현상, 부식, 박리 Process 통한 제품의 회로 구현	
	AOI	Image Matching을 통한 제품의 양/불량 여부 사전 점검	
PSR & Surface Treatment	PSR (Photo Solder Resist)	기판 표면에 잉크를 도포하여 PCB표면의 도금된 회로 보호	
	ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)	산화방지 및 SMT 용이성 위해 잉크가 도포되지 않은 동박 코팅 (Ni/Au 도금)	
	OSP (Organic Solderability Preservatives)	산화방지 및 SMT 용이성 위해 잉크가 도포되지 않은 동박 코팅 (Pre-Flux Coating)	

\*출처: 동사 홈페이지(2021), NICE평가정보(주) 재구성

■ 연구개발 진행 현황

동사는 품질경쟁력 강화를 위한 PCB 가공 기술을 지속적으로 개발 및 양산제품에 적용하고 있다. 홀 가공 시에는 홀이 한쪽으로 쏠리는 현상으로 오가공이 발생하기 쉬운데 홀 쏠림 현상이 발생한 제품의 데이터를 레이저 드릴 장비에 입력시켜 공정을 진행하게 되면 부정확한 가공으로 인해 쇼트 불량률 유발시킨다. 동사는 실제 가공할 제품과 유사한 두께를 갖는 타깃 보드를 사용하여 가이드 홀을 가공함으로써 정확성 향상과 품질 안정화를 구현하였다.

또한, 2020년에는 차량용 레이더 안테나 적용되는 PCB를 상용화하여 공급하기 시작하였으며, 홀 가공 시 드릴링 공정, 플라즈마 공정, 화학동도금 및 전기동도금 등 다수의 복잡한 공정을 적층, 홀 가공, 동도금 이후 패터닝을 형성하는 방식으로 공정을 단순화하면서도 레이더의 정밀도를 향상시킬 수 있는 가공 기술을 개발하여 적용 중에 있다.

동사는 2001년 설립한 기업부설연구소를 20년 이상 운영해 오고 있으며, 소형화, 초경량화, 고밀도화, 고속화 및 고주파화를 요구하는 제품수요의 증가에 따라 기술 트렌드에 부합하는 Build-Up PCB에 대한 연구개발을 진행하고 있다. 개발된 기술은 PCB 제품의 양산에 다양하게 적용되어 품질 제고, 원가 절감, 수출 향상에 기여하고 있다.

동사는 현재 D/F 회로 구현, Laser/CNC Drill 최적 가공, PSR 및 표면처리, 비아홀 Plating 기술에 대한 연구개발에 집중하고 있는 것으로 파악되며, 2021년에는 ‘Drill Entry Board 개발’, ‘Radar PCB L/D 가공 공법 개발’, ‘Whisker 개선 Tin 도금 공법 개발’, ‘Cavity PCB 인쇄 공법 개발’ 등에 대한 연구개발을 진행하였다. 한편, 동사는 2022년 1월 기준 50건의 등록 특허를 보유한 것으로 확인되며, 이는 신기술 공법(8건), PCB 공정 기술(39건), 원부자재(3건)에 대한 기술로 파악된다.

표 4. 동사 최근 연구개발 내역

과제명	연구기간	과제명	연구기간
저가 고품질 신규 Kraft Paper 개발	2020.01~06	전장품 강성 자재 적용 개발	2021.01~06
Drill Entry Board 개발	2020.01~06	Radar PCB L/D 가공 공법 개발	2021.01~06
Via Fill 약품 국산화 개발	2020.01~06	고속 Via Fill 광택제 개발	2021.01~06
고품질 현상단 세정제 개발	2020.01~06	저가 고품질 친환경 박리액 개발	2021.01~06
저가 고품질 PLUG 잉크 개발	2020.01~06	잉크 흐름성 강화 마킹 잉크 개발	2021.01~06
High Performance 원자재 개발	2020.07~12	저가 고품질 Copper Foil 개발	2021.07~12
All Depth Drill 개발	2021.07~12	Router 접합 BIT 개발	2021.07~12
Whisker 개선 Tin 도금 공법 개발	2021.07~12	화학동 SPS Type 에칭제 개발	2021.07~12
고밀착 드라이필름 개발	2021.07~12	텐팅용 고밀착 드라이필름 개발	2021.07~12
Cavity PCB 인쇄 공법 개발	2021.07~12	내약품성 강화 Tin 도금용 잉크 개발	2021.07~12

\*출처: 분기보고서(2021), 사업보고서(2021), NICE평가정보(주) 재구성

## Ⅱ. 재무 분석

### 국내시장 경쟁 완화되며 매출과 이익 증가

Build-Up PCB 수출을 중심으로 매출을 시현하고 있는 가운데, 최근 국내 경쟁사의 사업 철수에 따른 낙수효과로 동사의 내수 시장점유율이 확대되며 매출은 성장했고 수익성은 개선되었다. 2021년 3분기 누적 매출도 증가하였으나, 부채비율이 높은 편이고 현금유동성은 다소 미흡한 수준이다.

#### ■ 최근 내수시장 점유 확대되며 2020년 외형 회복

동사의 주력 사업은 Build-Up PCB의 생산 및 판매로, 2020년 개별 결산기준 전년 대비 11.4% 성장한 3,013억 원의 매출을 시현하며 외형 회복한 모습을 보였다. 수출 주력 기업으로 PCB 제품 중 수출이 2,210억 원으로 매출비중의 73.3%를 기록해 실적을 견인하고 있는 가운데, 최근 내수 실적이 꾸준히 성장(2018년 260억 원, 2019년 438억 원, 2020년 682억 원)하며 매출 비중이 22.6%로 늘어났다. 국내 경쟁사들의 HDI 사업 철수로 시장점유율이 확대된 것이 매출 증가를 이끈 것으로 파악된다. 한편, PCB를 제외한 그 외 부산물 매출은 212억 원 수준으로 매출의 4.0%를 차지하고 있다.

그림 1. 동사 연간 및 3분기 요약 포괄손익계산서 분석



매출액/영업이익/당기순이익 추이

증가율/이익률 추이

\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

그림 2. 동사 연간 및 3분기 요약 재무상태표 분석



자산총계/부채총계/자본총계 추이

유동비율/자기자본비율/부채비율 추이

\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

### ■ 시장 경쟁 완화로 수익성 개선

3천억대 규모로 외형 회복하며 판관비 부담은 3.6%로 소폭 완화되었으며, 매출원가율도 2019년 93.7%로 낮아지면서 전반적인 수익성은 개선되었다. 7~8년 전 과도한 투자와 신규 업체 수 증가로 업종 내 경쟁이 치열해짐에 따라 수익성이 악화되었지만, 최근에는 이를 버티지 못한 경쟁자들의 사업 철수 등으로 시장 경쟁이 약화되며 다시 수익성이 개선되는 모습을 보이고 있다. 2020년 영업이익 82억 원, 당기순이익 50억 원(매출액영업이익률 2.7%, 매출액순이익률 1.7%)을 시현해 아직 수익구조는 미흡한 수준이나, 사업을 정리한 국내 기업들의 물량을 흡수를 통한 매출 증가와 마진을 개선이 기대되고 있다.

### ■ 2021년 3분기도 매출 성장

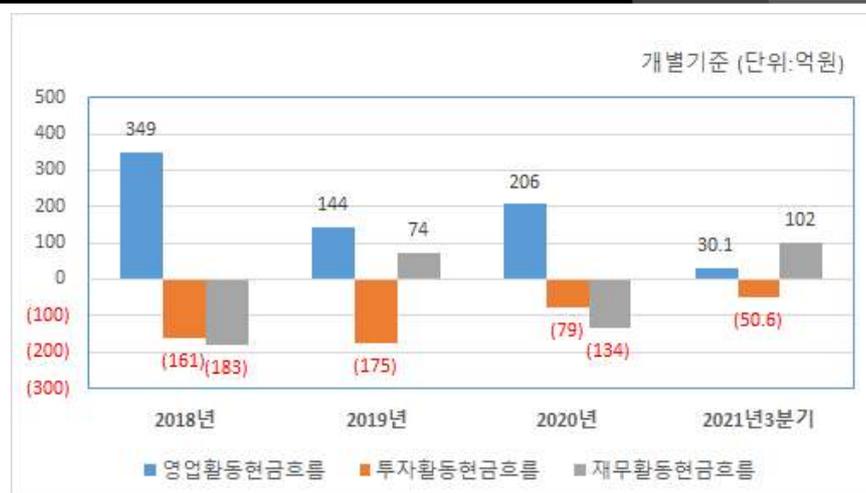
2021년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 10.1% 증가한 2,269억 원으로 2020년에 이어 매출 성장 기조를 나타내고 있다. PCB 제품 중 수출의 경우 1,676억 원(매출비중 78.8%)으로 여전히 양호한 실적을 이어가고 있으며, 내수 부문에서는 452억 원(매출비중 21.2%), 부산물 부문에서는 109억 원(매출비중 5.1%)의 실적을 각각 달성하였다. 판관비와 매출원가 부담은 전기말과 유사한 수준을 보이며 영업이익 51억 원, 당기순이익 41억 원(매출액영업이익률 2.3%, 매출액순이익률 1.8%)을 기록하였으나, 업계 대비 미흡한 수익구조가 지속되었다.

2021년 3분기 말 총자산은 2,372억 원 규모이며, 유동비율 103.1%, 자기자본비율 45.6%, 부채비율 119.3%의 제안정성 지표를 기록해 전반적인 재무구조는 미흡한 수준으로 지속되고 있다.

### ■ 정(+의) 영업활동현금흐름 유지

2020년 영업활동현금흐름은 순이익 증가와 현금 유출이 없는 감가상각비의 가산으로 전년 대비 개선된 206억 원을 시현하였다. 유형자산 취득에 필요한 79억 원의 투자활동 소요자금과 차입금 상환 등과 같은 재무활동 소요자금은 영업활동현금 및 기보유 현금을 통해 충당하였다. 기말 현금성자산은 전년 대비 감소한 88억 원을 기록한 바, 다소 미흡한 수준의 현금유동성을 지속하였다.

그림 3. 동사 현금흐름의 변화



\*출처: 동사 사업보고서(2020), 분기보고서(2021)

### Ⅲ. 주요 변동사항 및 전망

#### 국내 HDI 시장 경쟁구조 재편 및 적용분야 확대에 따른 긍정적 실적 전망

국내 HDI PCB ‘빅3’ 업체의 사업철수로 인한 경쟁구조 재편과 삼성전자의 스마트폰 HDI 공급 물량 증가에 따른 시장변화와 자동차 전장용 PCB로 동사 제품의 적용 분야를 확대함에 따라 이와 관련된 매출실적 증가가 기대된다.

##### ■ 주요 사업 이슈

국내 HDI PCB 시장은 1990년대 중후반부터 삼성전기와 LG이노텍, 대덕전자가 20여 년간 이끌어 왔다. 삼성전기와 대덕전자는 삼성 휴대폰, LG이노텍은 LG 휴대폰의 주기판을 생산해 왔다. 수익성 저하로 인해 2019년 삼성전기, LG이노텍이 HDI 사업을 철수한 데 이어 대덕전자가 2018년 그룹 계열사인 대덕GDS에 HDI 생산설비를 매각한 후 소량씩 만들어 온 HDI의 생산까지 2020년 전면 중단하기에 이르렀다. 이로써 현재 국내 HDI PCB 시장의 ‘빅3’은 동사와 코리아씨키트, 이수페타시스로 재편되었다.

삼성전자가 2020년 갤럭시노트 20/Z 폴드2를 출시하고 삼성전기가 2019년 HDI 사업을 철수함에 따라 전체 HDI 공급 물량이 늘어났으나, 장기적으로는 ODM 스마트폰 제조의 비중이 높아져 국내 업체의 공급 물량은 줄어들고 가격경쟁력을 무기로 내세운 중국 업체로 인해 치열한 경쟁구도가 펼쳐질 것이라는 의견이 지배적이다.

##### ■ 전망 및 이슈

동사는 이동통신단말기용, 전자제품용, 자동차 전장용 PCB 제조사로 이동통신단말기용 PCB의 비중이 무려 90%에 달하였다. 동사는 2여 년의 연구개발 끝에 2020년 차량용 레이더 기판을 상용화하여 현대모비스에 납품하기 시작하였고, 이에 따라 자동차 전장용 PCB의 비중도 크게 증가하였다. 현대기아차가 부품 국산화를 추진하면서 독일 보쉬에서 공급받던 차량용 레이더를 현대모비스 제품으로 대체하였고, 현대모비스의 PCB 공급망에 포함된 동사가 수혜를 받게 된 것이다.

자동차 레이더 PCB를 포함한 자동차 전장용 PCB는 고집적화, 소형화의 기술에 기여할 뿐만 아니라 고온 및 고전압 등의 자동차 환경에 특화된 제조 기술이 요구되며, 사용자의 안전과 직결되는 제품특성 상 진입장벽이 높아 제품 신뢰성, 기술력 등 우수한 해외 기업이 선도하고 있는 분야이다. 자동차의 전장화로 더 많은 전자부품이 탑재될 것으로 예상되며, 관련 시장 또한 지속적인 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.

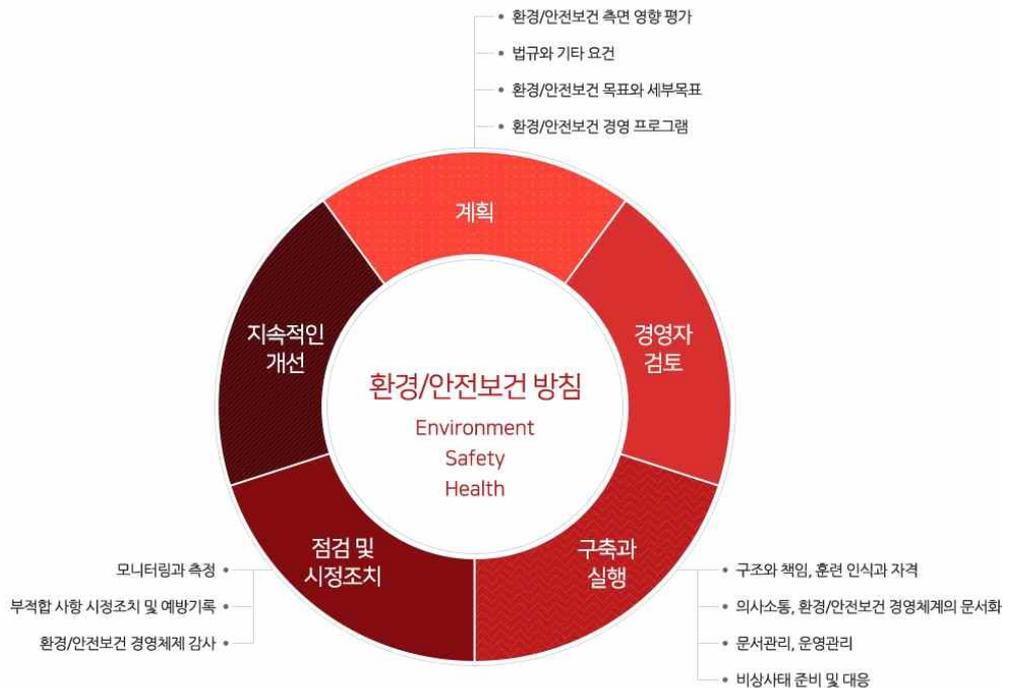
스마트폰에 적용되는 HDI PCB를 주로 생산해 온 동사는 차량용 레이더 기판으로 적용처를 다변화함에 따라 이와 관련된 실적 증가가 기대되는 바, 자동차용 PCB 표면처리 기술 등 관련 연구개발에 더욱 매진할 것으로 전망된다.

■ ESG 활동 현황

동사는 평가일 현재 ESG 평가 이력이 없는 것으로 확인되나, 동사의 경영진은 ESG 이슈를 충분히 인지하고 있고, 기업의 비전과 목표, 이에 따른 전략·과제·실행 체계 등 ESG를 반영한 경영전략을 마련하기 위해 다각도로 논의를 진행 중인 것으로 파악된다. 동사가 현재 진행하고 있는 ESG 활동 현황은 다음과 같다.

(환경) 동사는 생산 활동으로 인한 환경 영향에 대한 조사 및 분석, 환경 정보를 공개하고, 환경 경영 조직을 설치하여 운영 중인 것으로 파악되며, 임직원을 대상으로 환경 교육을 진행하고 있다. 또한, 환경과 안전을 경영의 최우선 가치로 두고 기업활동 전반에 걸쳐 ISO14001 및 ISO45001을 기반으로 하는 환경 및 안전보건 경영체제를 구축하고 있다. 또한, 안전보건 관리 책임자를 두어 영위 사업과 관련된 각종 환경 법규를 준수하고 제조 공정에서 발생하기 쉬운 환경 위반사항을 사전에 예방하기 위해 적극적인 환경 점검 및 관리를 진행 중인 바 환경 부문의 경영 활동은 비교적 활발히 추진 중인 것으로 파악된다.

그림 4. 동사 환경 및 안전보건 방침



\*출처: 동사 홈페이지(2021)

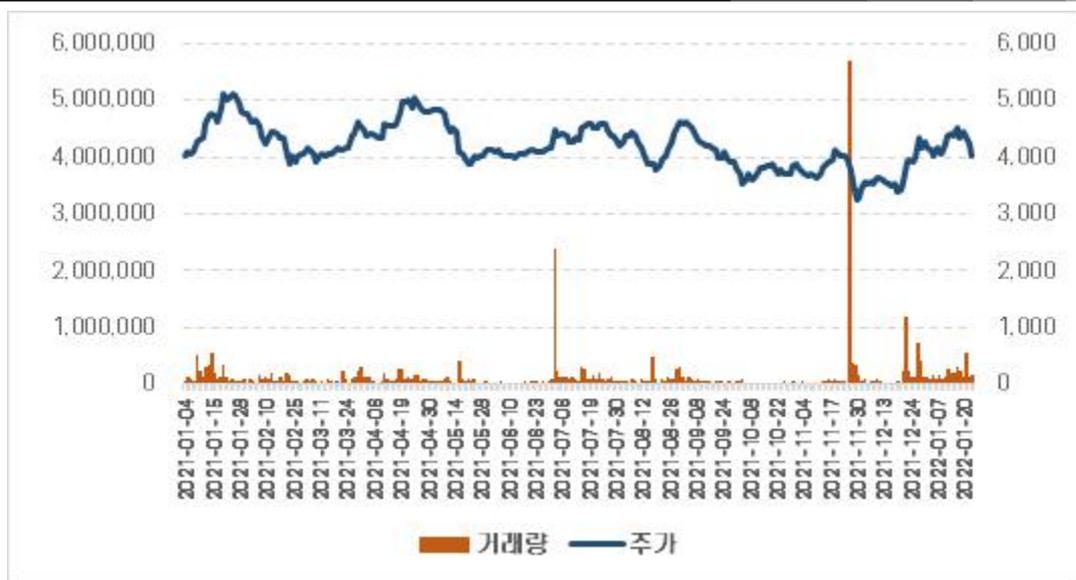
(사회) 동사는 고객, 주주, 임직원, 지역사회 및 국가에 대한 책임과 의무에 대한 윤리규정을 두고 각 대상별 기본 윤리와 실천과제 등을 명시하고 있다. 또한, 임직원 개인의 공정한 직무수행을 위한 기본 윤리를 규정하고 있는 등 내부적으로 건전한 기업문화를 진작시키고 외부적으로 공정한 경쟁과 윤리경영을 통해 기업의 사회적 책임을 수행하는데 필요한 가치판단의 기준을 제시하고 있다. 다만, 협력사 지원 프로그램, 사회공헌 프로그램은 보유하고 있지 않은 것으로 파악된다.

(지배구조) 당사는 4인으로 구성된 이사회를 운영하고 있으나, 사외이사의 비중은 25%로 다소 낮은 편이며 감사위원회는 운영하고 있지 않은 것으로 파악된다. 또한, 별도의 중장기 배당 정책 등은 보유하고 있지 않은 것으로 파악되나, 매년 상장회사로서의 공시 의무를 준수하며 홈페이지에 기업 및 사업현황에 대한 최신자료를 게시하는 등 이해관계자의 권익보호를 위한 노력을 전개하고 있는 것으로 파악된다.

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 최근 6개월 이내 발간 보고서 없음</li> </ul>		

■ 시장정보(주가 및 거래량)



\*출처: Kisvalue(2022.01)